

Proceso de Fabricación

Nuestro proceso de fabricación comienza con la selección de materias primas de primera calidad, controlando que estas cumplan con lo establecido en nuestra normativa nacional, NCH 2148, NCH 2150, NCH 2165.

Una vez eliminados los defectos naturales de las piezas de madera, se procede a fabricar las láminas de acuerdo al grado de calidad requerido (Grado A o B, NCH 2150). El espesor máximo para elementos rectos será,

$e_{\max} = 45 \text{ mm.}$ y para elementos curvos se calculará de acuerdo al radio de curvatura.

El encolado de láminas se realiza con Resorcinol Fenol Formaldehído o Urea Melamina, según las condiciones de humedad en la que se encontrará la estructura de Madera Laminada.

Las uniones de canto entre láminas se realizan por el sistema finger-joint. A través de este procedimiento es posible obtener estructuras con las más diversas configuraciones y alcanzar grandes luces sin mayores problemas.

Normativa Empleada

Los productos fabricados por Coprema respetan estrictamente los requisitos y especificaciones establecidos en la Normativa Chilena: NCH 2148, "Madera Laminada Estructural - Requisitos o Inspección" NCH 2150, "Madera Laminada Encolada - Clasificación mecánica y visual de Madera Aserrada de Pino radiata" NCH 2165, "Tensiones admisibles para la madera laminada encolada estructural de Pino Radiata".

Certificación de Calidad del Producto

Control permanente Gestión de Calidad Fundación Chile.

- Ensayos
- Cizalle a través del adhesivo
- Delaminación (Ciclo de envejecimiento)
- Niveles de Humedad

Propiedades Mecánicas Admisibles

Tensión Admisible de Flexión 5.5 MPa a 8.2 MPa.

Tensión Admisible de Compresión paralela 6.0 MPa a 10.5 MPa

Tensión Admisible de Cizalle 1.3 MPa

Tensión Admisible de Compresión normal 2.8 MPa

Tensión Admisible de Tracción paralela 3.0 MPa a 5.9 MPa

Tensión Admisible de Tracción normal 0.2 MPa

Módulo de Elasticidad en Flexión 8850 MPa a 10450 MPa

Módulo de Elasticidad en Compresión Paralela 7500 MPa a 10200 MPa

Lamitec
COPREMA

